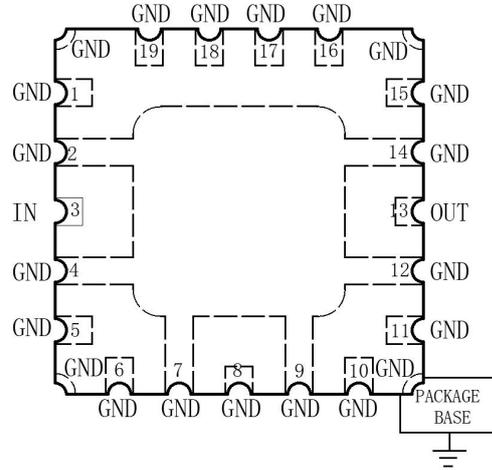




### 性能特点

- 输入频率: 4 - 8 GHz
- 输出频率: 8 - 16 GHz
- 转换损耗: 13 dB
- 基波隔离: >40 dBc
- 无源式: 不需直流供电
- 陶封尺寸: 19Lead, 4mm × 4mm QFN

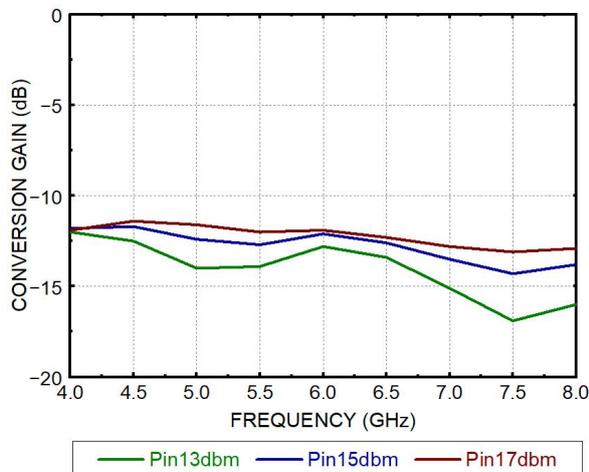
### 功能框图



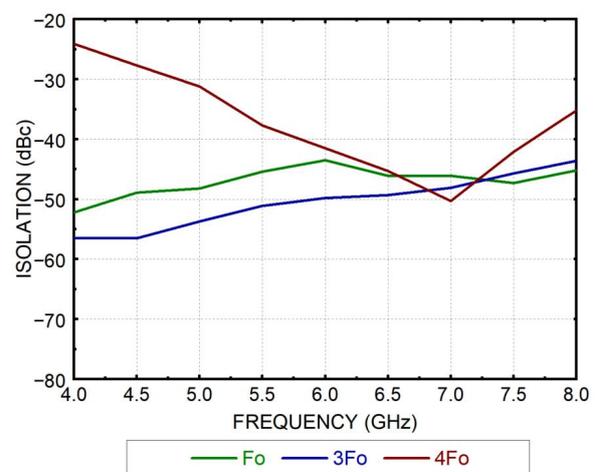
### 电特性参数 ( $T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $Input = +15\text{ dBm}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
输入频率范围	4 - 8			GHz
输出频率范围	8 - 16			GHz
转换损耗		13		dB
基波隔离度 (相对于输入功率)		45		dBc
三阶谐波隔离度		45		dBc
四阶谐波隔离度		30		dBc

### 转换增益 vs. 驱动功率



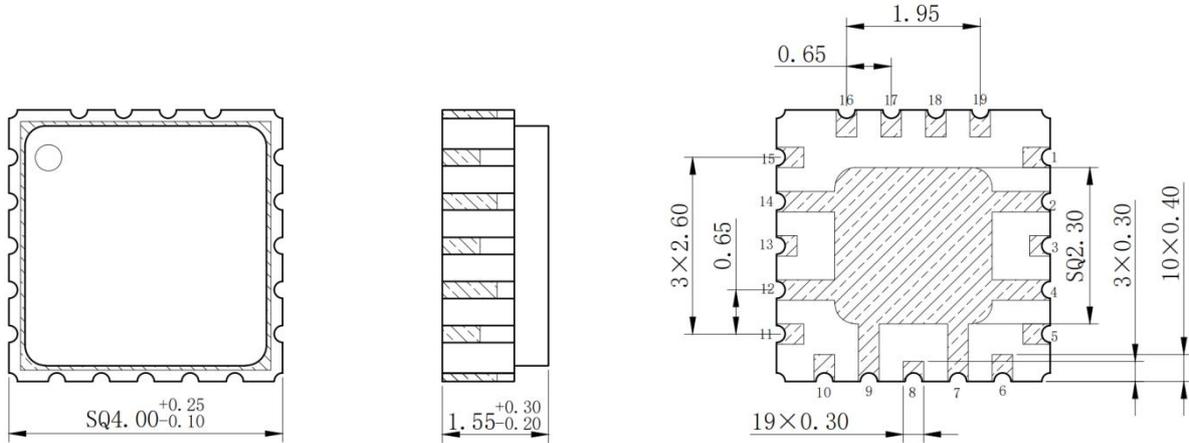
### 隔离度@15dBm驱动功率





## 物理参数

单位: mm



### 注意事项:

- 1、器件在干燥、氮气环境中存储;
- 2、器件对静电敏感, 在储存、运输、装配和使用过程中注意防静电;
- 3、所有接地引脚请连接 RF/DC 地;
- 4、该产品适用于回流焊贴装工艺, 回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$ , 回流焊使用时需要做去金预处理。

## 引脚描述

引脚序号	功能	描述
3	IN	该引脚为 RF 输入, DC 耦合, 在 4-8 GHz 频段内匹配至 50 Ohm。若 RF 电位不是 0V, 需外接隔直电容。
13	OUT	该引脚为 RF 输出, DC 耦合, 在 8-16 GHz 频段内匹配至 50 Ohm。若 RF 电位不是 0V, 需外接隔直电容。
其余	GND	必须连接至 RF/DC 地
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地

## 极限参数

1. 射频输入功率: +24 dBm
2. 储存温度:  $-65\sim+150^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度:  $-55\sim+85^{\circ}\text{C}$